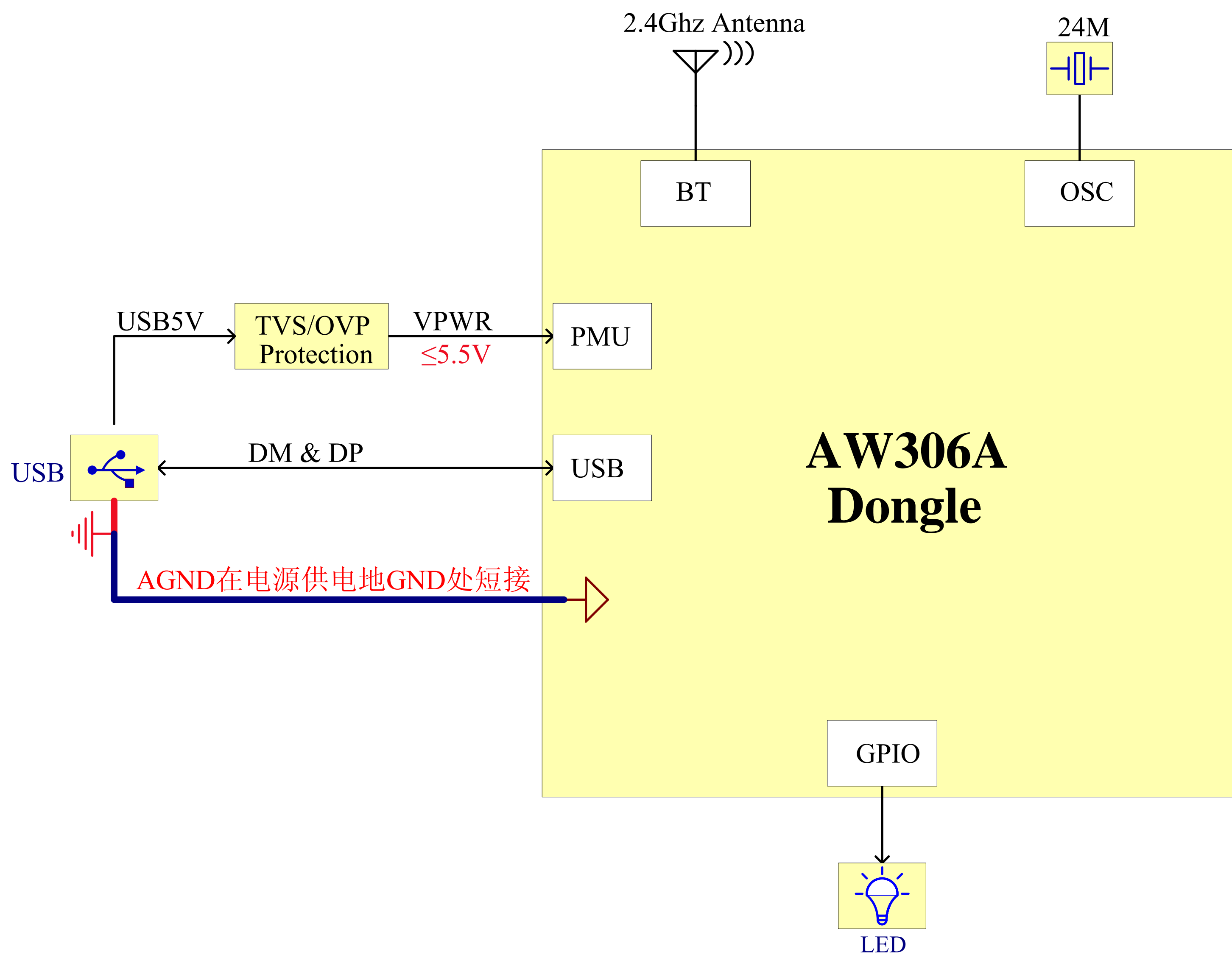
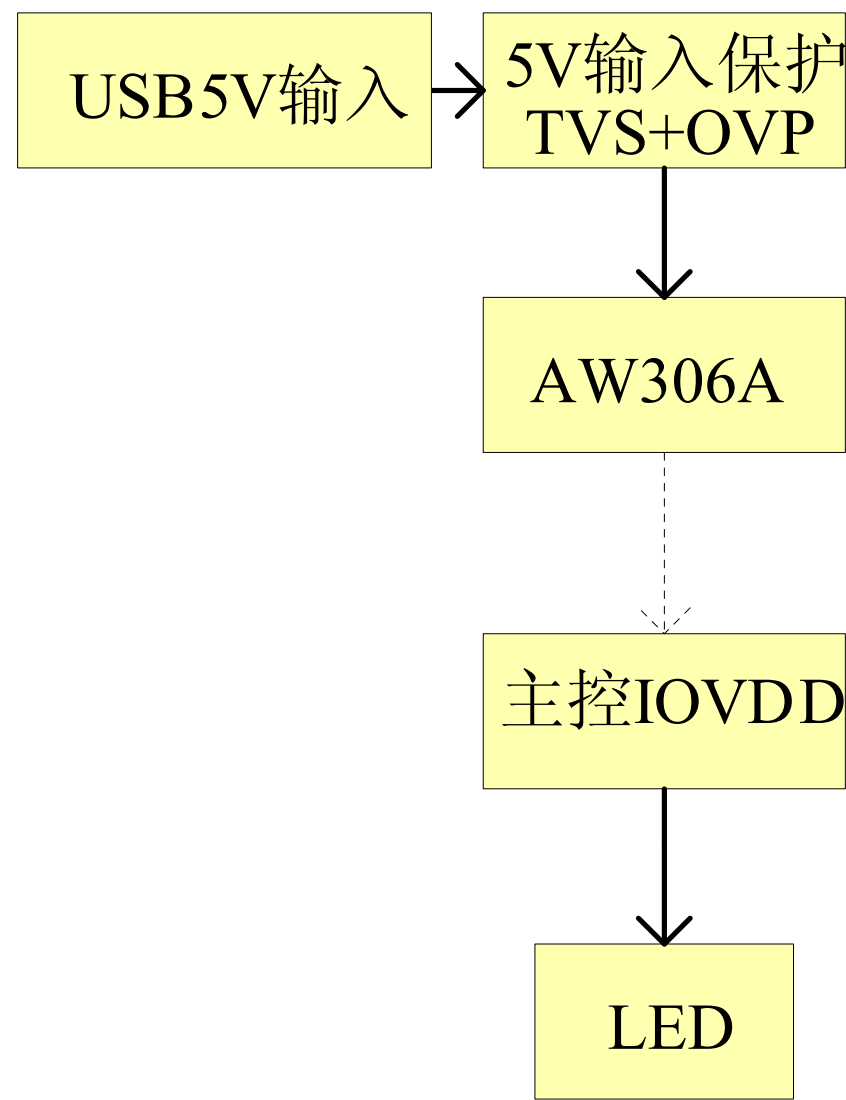


版本更新说明		
版本号	更新日期	更新说明
V1.0	2023.11.09	初始版本

AW306A BLE蓝牙Dongle硬件框图



供电路径





版本更新说明

版本号	更新日期	更新说明
V1.0	2023.11.09	初始版本

杰理方案咨询(QQ号:1418295957，邮箱:fae@zh-jieli.com)

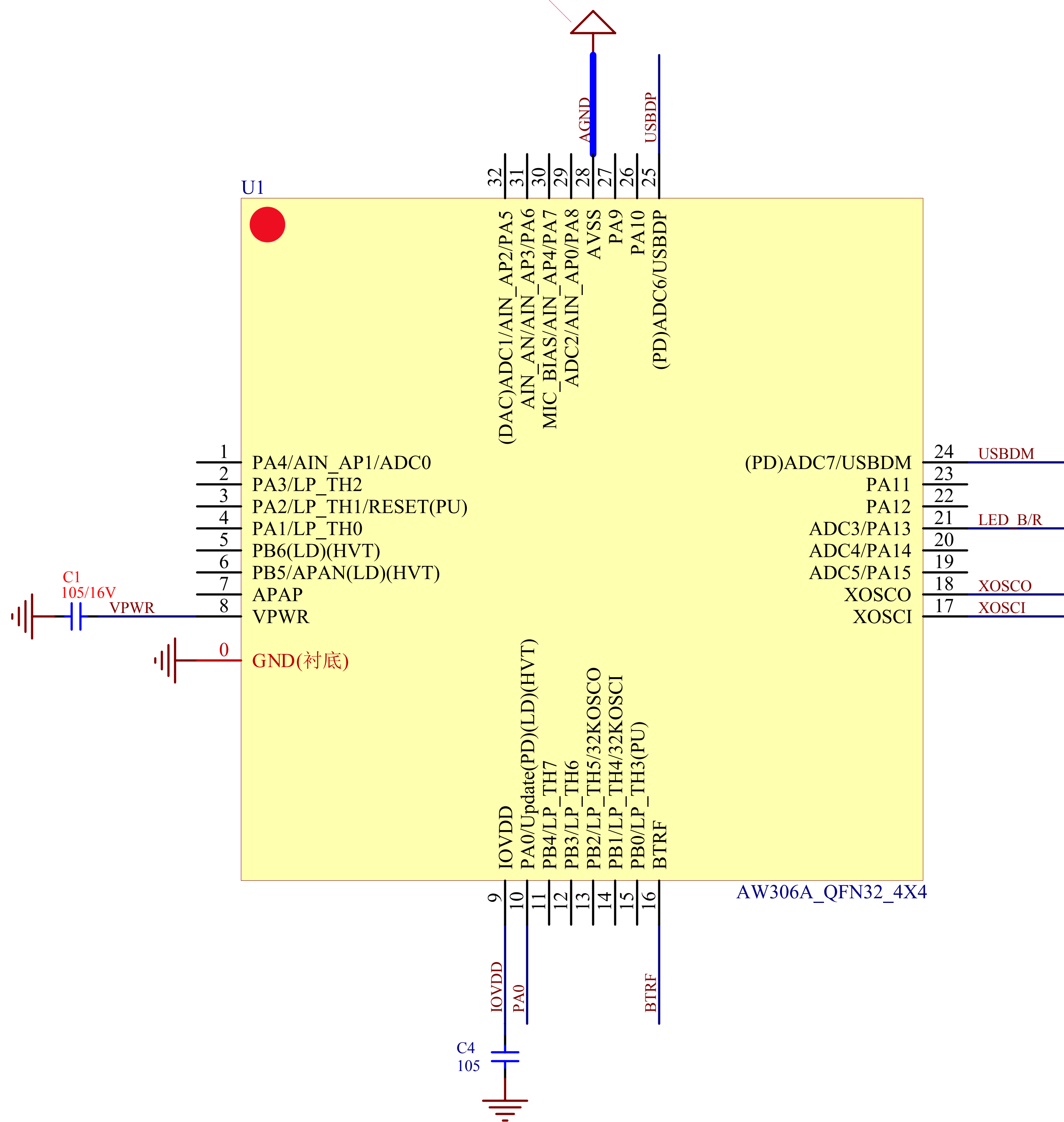
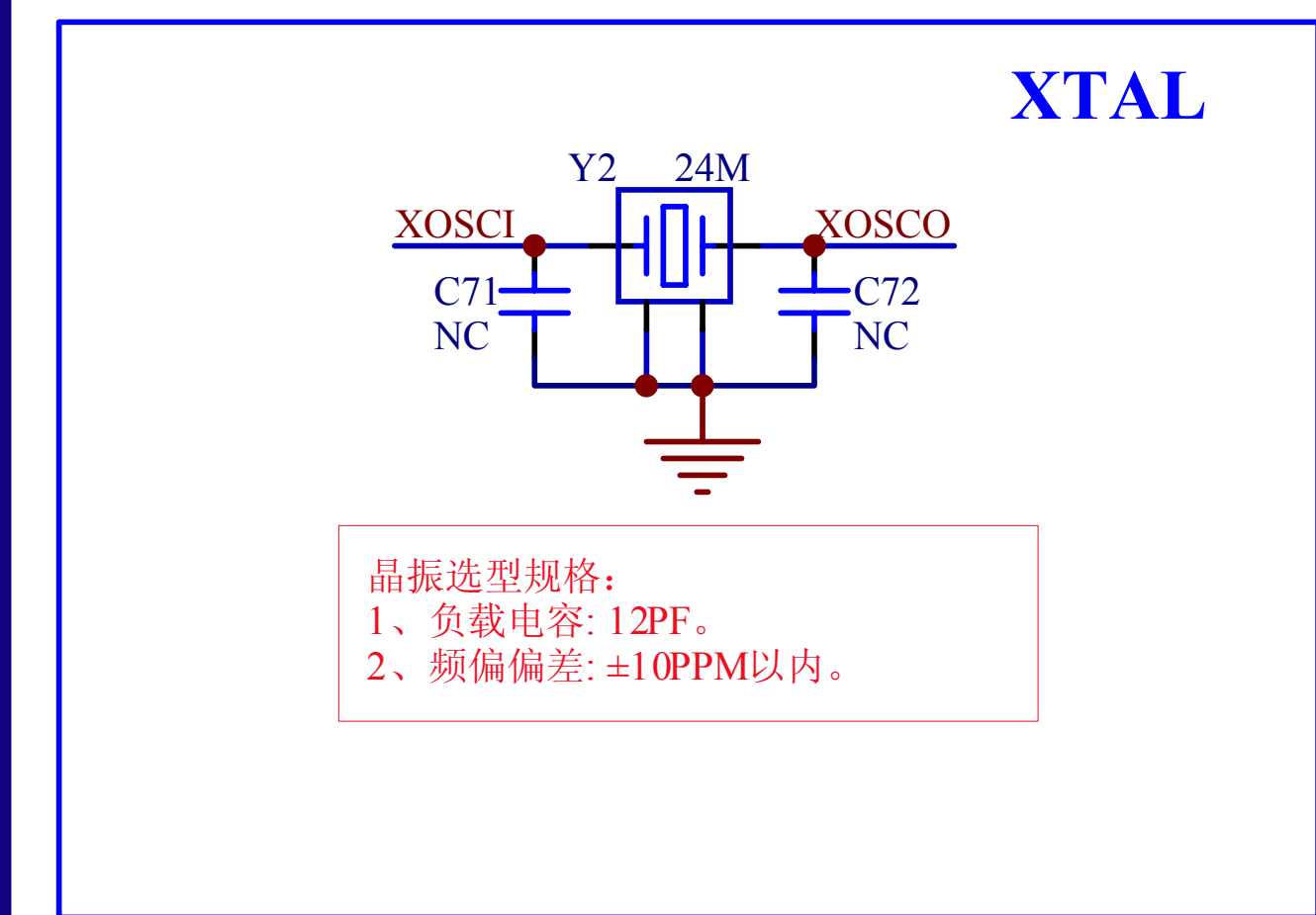
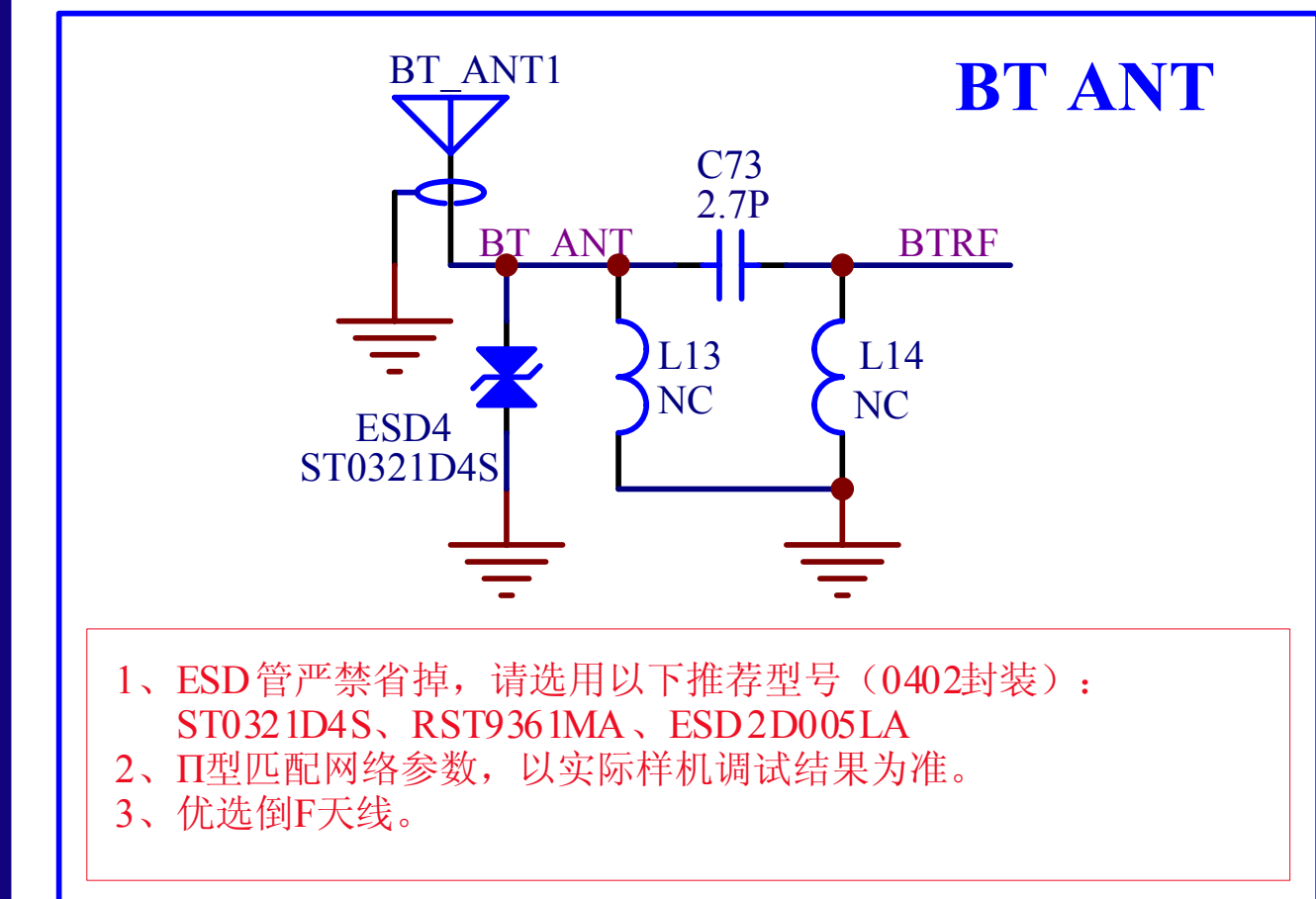
<p>产品安全规范：</p> <p>1、电源选型</p> <p>a、注意供电场景，严格控制输入电压范围。</p> <p>供电至VPWR，不和IOVDD短接（≤5.5V，如3.7V锂电池/5V适配器应用），或供电至VPWR，和IOVDD短接（≤3.4V，如3.0V纽扣电池/节干电池应用）。</p> <p>b、注意供电保护，防过压/过流/反接/浪涌等（如纽扣电池应用，必须考虑防反接电路保护）。</p> <p>2、电容选型</p> <p>a、注意容值随电压升高而下降，请确保工作电压下的容值（优选0402或更大尺寸的封装）。</p> <p>b、请使用原装电容（非拆机、劣质电容），以保证容值和品质。</p> <p>c、主控VPWR退耦电容耐压值要求≥16V，主控其他电容耐压值≥6.3V；其它外接电容依据其工作要求选择（防止浪涌、过冲击穿）。</p> <p>3、静电选型</p> <p>a、整机静电标准必须≥（接触±4KV，空气±8KV）。</p> <p>b、天线输入端必须加ESD管，请使用推荐型号。</p> <p>4、浪涌选型</p> <p>a、抗浪涌值一般要求≥±48V（根据实际应用场景调整），建议留有余量设计。</p> <p>b、VPWR输入端必须加TVS管，请使用推荐型号。</p>	<p>设计注意事项：</p> <p>1、电源：</p> <p>1) 内置电源输入单元，支持供电至VPWR（不和IOVDD短接，输入≤5.5V；和IOVDD短接，输入≤3.4V）。</p> <p>2) IOVDD默认3V电源域输出，不可关闭，电压档位可设，2.1V≤IOVDD≤3.4V，Imax≈120mA(包含主控IO消耗)；连接外设时，应避免过载输出。</p> <p>3) HPVDD是APA音频模块的电源输入端，和VPWR短接（或合绑），其电压大小决定APA模块输出功率。</p> <p>2、音频：</p> <p>1) 内置1路16位Audio DAC，支持1路单端输出（固定出口PA5），支持外挂PA输出。</p> <p>2) 内置1路16位Audio ADC，支持AIN_x音频输入（x代表A通道），可选MIC或AUX输入，支持单端或差分，支持输入≤1.5Vpp@单端（或2.8Vpp@差分）。单端时，输入可选AIN_APx。差分时，AIN_APx为正端，AIN_AN为负端。x代表0/1/2/3/4通道。</p> <p>注1：Audio ADC默认无省电容模式，若要支持MIC省电容单端输入，会牺牲一部分输入动态，且MIC仍需外供偏置电压（MIC_BIAS）。</p> <p>注2：AIN_AP4（固定出口PA7），和MIC_BIAS合绑，一般用于MIC供电，可选内置上拉0.5~10KΩ输出。</p> <p>注3：AIN_AP3（固定出口PA6），和AIN_AN合绑，一般用于差分负端输入。</p> <p>3) 内置APA模拟D类功放单元，支持桥式负载（BTL）和并联桥式负载（PBITL）2种输出模式，支持直推高功率喇叭，不支持立体声。</p> <p>注：APAP/APAN，若无音频应用，可用作IO输出，一般仅用于PWM或UART_TX外设，“APA输出电压”必须限制在“外设的电源域”。</p> <p>3、IO：</p> <p>1) 除固定IO，其他IO根据需求，依据芯片规格书IO说明进行灵活分配。</p> <p>2) 所有GPIO均可配置唤醒口（边沿触发），软关机唤醒时，IO状态可保持。</p> <p>3) PA2支持外部持续4秒低电平触发复位，支持重映射，可软件烧写屏蔽。</p> <p>4) PA0可做串口烧写更新程序，应用时主控不能断电。</p> <p>5) PA0/USBDM/USBDP上电默认下拉，PA2/PB0上电默认上拉。</p> <p>6) USBDM可配上拉180KΩ，下拉15KΩ，USBDP可配上拉1.5KΩ，下拉15KΩ。其他IO可配内部上下拉10KΩ/100KΩ/1MΩ。</p> <p>7) PB5/PB6/PA0为高压IO，耐压≤（5.5V或2倍IOVDD中最小值），只能弱驱（8mA）。</p> <p>USBDM/DP可做普通IO（驱动电流30mA），其余IO驱动电流可选3/8/20/40~50mA四档。</p> <p>注：若无USB功能应用，USBDM/DP一般仅用于IO按键或输入检测功能等。</p> <p>8) ISP、SFC、SPI0、RTC、低功耗触摸唤醒、ADC检测、音频AUDIOIO等外设，均为固定IO，严禁随意分配。</p> <p>9) IIC、ALINK、SPI1/2、UART、SD、TIMER/PWM/MCPWM/CAP/CLKOUT等外设，支持crossbar映射，可灵活分配IO，支持映射到除PF组外的IO，如PA组、PB组等。</p> <p>10) RF、晶振、模拟AUDIOIO等信号相邻IO，严禁分配高速跳变信号，且应做好隔离，避免干扰。</p> <p>注：GPIO重映射对于高速数字信号通信可能产生影响，建议优先使用默认端口。</p>
--	--

IO名词解析：

HD：强驱；LD：弱驱；  
PU：上电默认上拉；PD：上电默认下拉；  
HVT：耐高压IO（5.5V或2倍IOVDD中最小值）；  
RESET：长按低电平硬复位；  
Update：串口烧写升级；  
AIN\_x：模拟音频输入（x为通道）  
ADCx：ADC采样输入检测（x为通道）  
LP\_Thx：内置触摸（x为通道）

AGND走线要求：

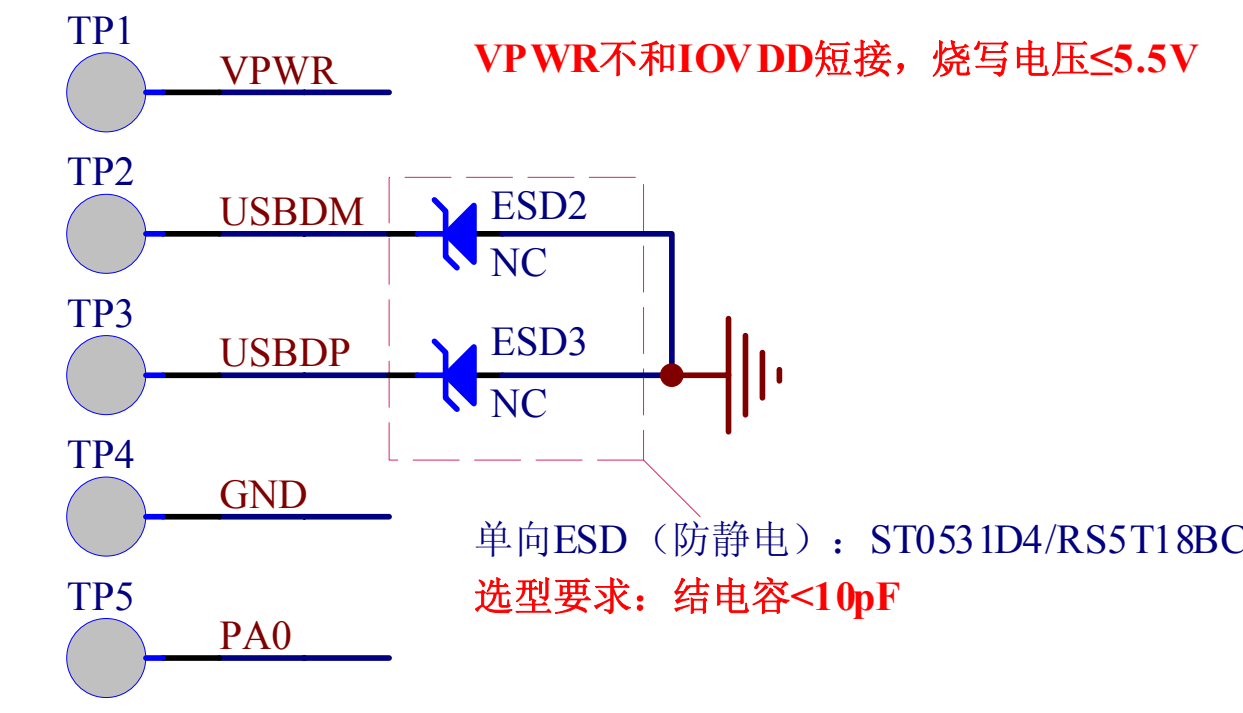
AGND处走线要求：  
1、PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）  
2、AGND走线顺序：音频设备AGND->主控AGND管脚->功放Bypass电容地或总电源供电入口GND处短接。  
即MIC/AUX/PA等音频模拟地，单独大面积走线至主控AGND管脚，再从主控AGND管脚，单独走线到功放Bypass电容地或总电源供电入口GND处短接  
注：若板空间受限，可尝试AGND在主控衬底地处短接（注意验证音频设备是否有噪声）。



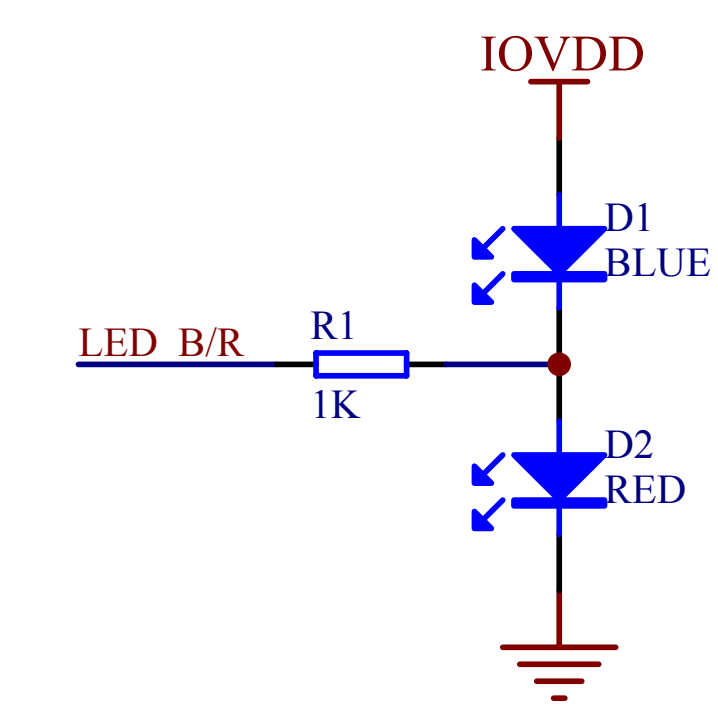
烧写场景说明

烧写场景	烧写说明	预留烧写测试点	备注
USB更新程序	VPWR、USBDM、USBDP、GND		
串口更新程序	VPWR、PA0、GND		

预留测试点，方便烧写、升级、测试



Test Point

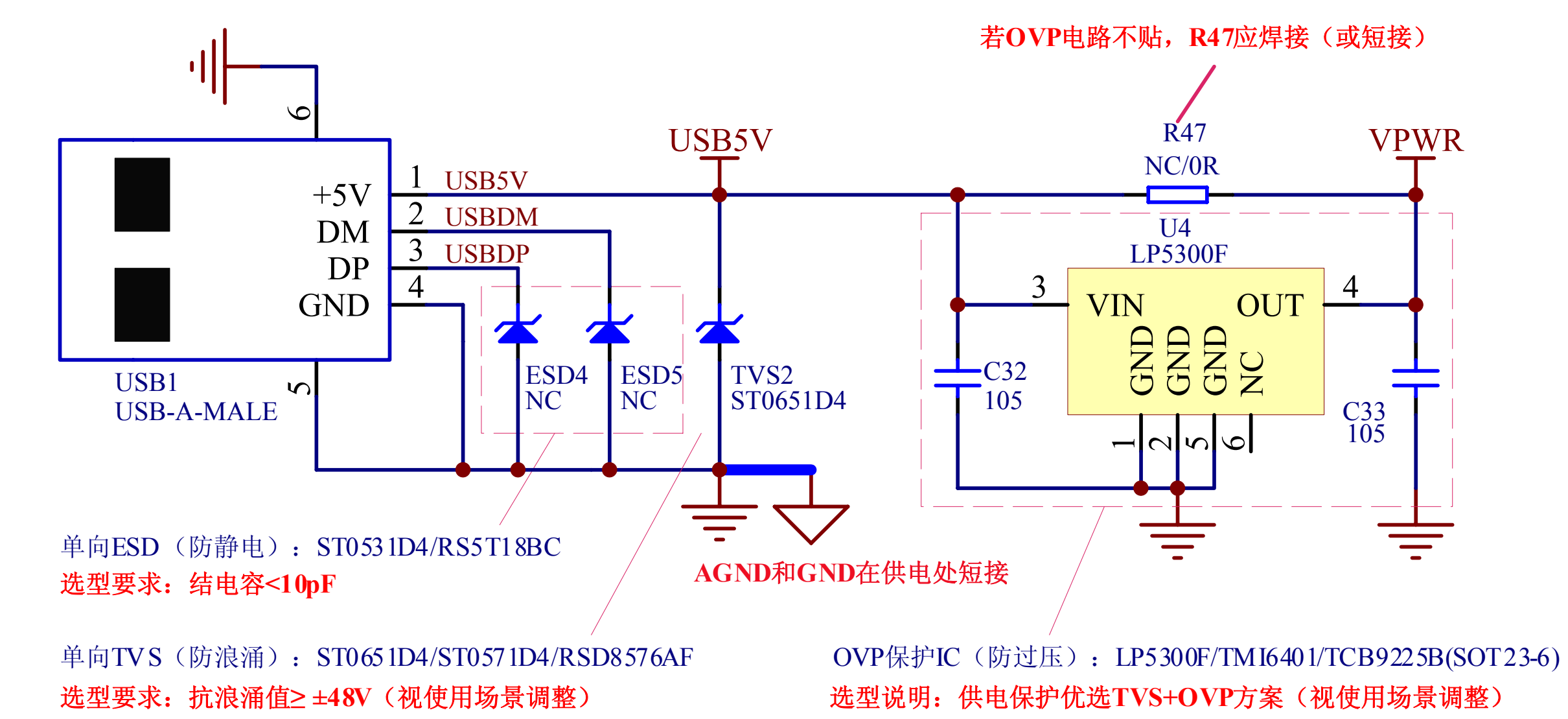


LED

供电场景说明

供电场景	供电说明	输入电压	适用场景
供电至VPWR（不和IOVDD短接）		≤5.5V	如USB5V接口供电等

注：电源输入需做好保护，防过压/过流/反接/浪涌/静电等。连接外设时，应避免过载输出。



POWER

MCU